



aemc

新應材股份有限公司

Advanced Echem Materials Company Ltd.

股票代號：4749

法人說明會

免責聲明

- 本公司對其現況的期待及預測是屬於前瞻性陳述的範疇，本身具有重大風險及不確定性，而致實際結果可能與前瞻性陳述內容有明顯差異。
- 本公司對於前瞻性陳述不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性陳述的義務。
- AEMC's statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties and actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements.
- AEMC makes no representation or warranty regarding such forward-looking statements. Except as required by law, AEMC undertakes no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

新應材的使命與願景

使命Mission

建立上下游供應鏈

建立台灣半導體先進製程特化材料自主技術，
並透過合作提升本土特化材料上、下游產業鏈的
全球競爭優勢。

願景Vision

擴大黃光微影材料品項及市佔率

持續精進合成、純化、配方和製程技術，
滿足客戶需求以協助提升良率，創造卓越的附加價值，
成為具全球競爭力的創新型特化材料企業。

重要肯定

- 2022年台積電優良卓越供應商- 黃光材料開發合作與量產支援
- 2023年經濟部國家產業創新獎

公司簡介

實收資本額：NT\$925,624千元
US\$30.9 million

員工人數：465人 (2026.04)
研發人員：138人 (2026.04)

主要產品

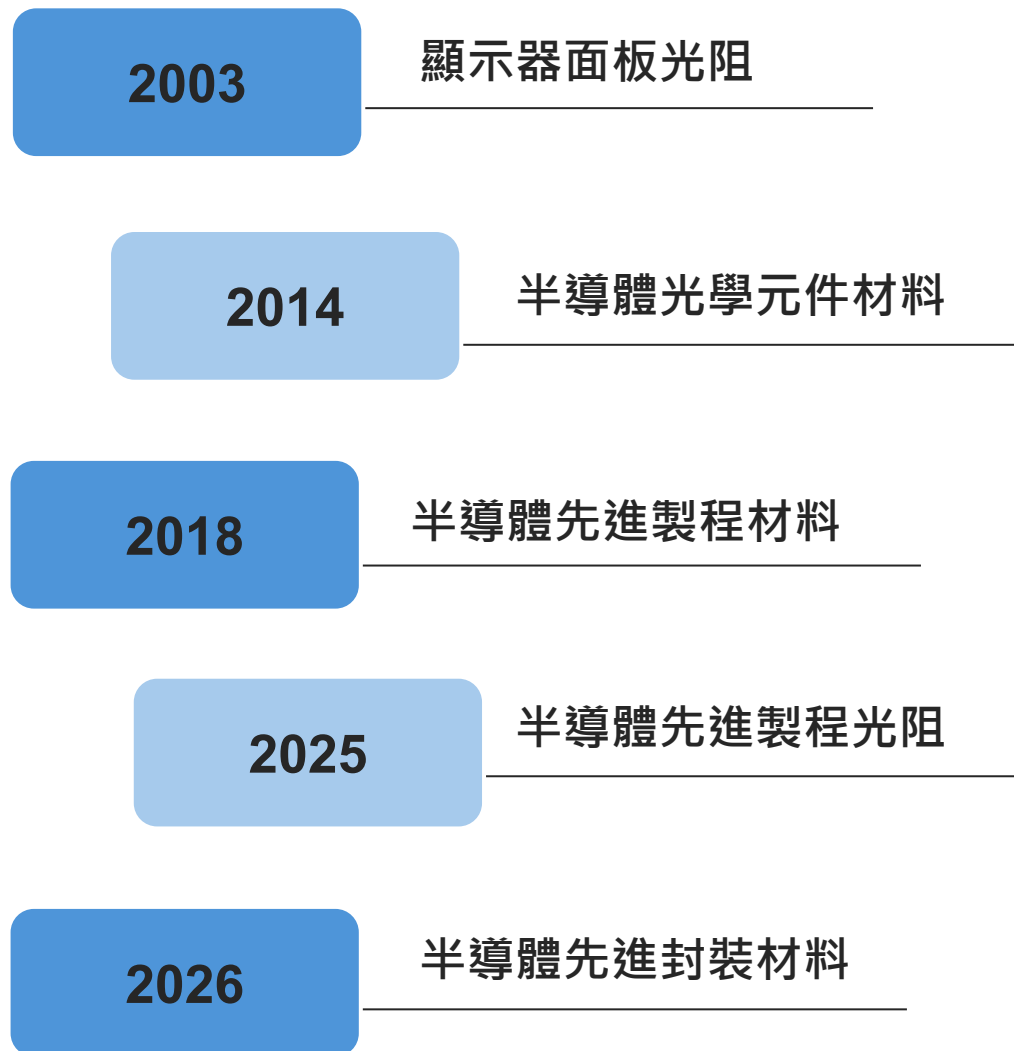
- 半導體特化材料：
先進製程材料
先進封裝材料
光學元件材料
- 顯示器特化材料：
顯示器光阻

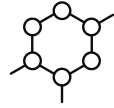
桃園廠暨研發中心： 研發中心、顯示器特化材料、半導體光學元件材料
台南廠： 半導體特化材料
高雄廠P1、P2(驗證中)：半導體特化材料

轉投資企業

- 新應材日本： 子公司100%
- AEMC USA： 子公司100%
- 思微合成生技： 子公司 70%
- 歐利得材料： 轉投資40%+特別股13.34%
- 昱鐳應材： 轉投資26.28%
- 新寶紘科技： 轉投資26.87%
- 富宸材料： 轉投資(程序進行中)

公司簡介





半導體特化材料

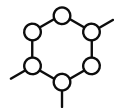
-先進微影製程

- 表面改質劑(Rinse)
- 底部抗反射層(BARC)
- 洗邊劑(EBR)
- 清洗劑(Cleaner)

-先進封裝材料

-光學元件材料

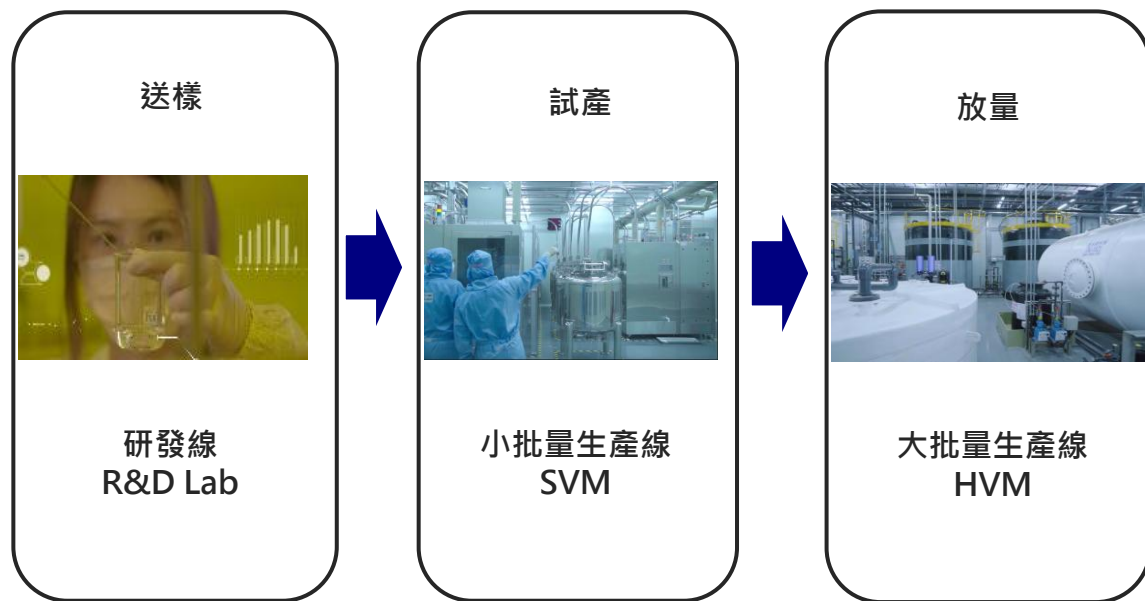
- 影像感測器材料
- 微型光學元件材料



顯示器特化材料

-顯示器光阻劑

研發及生產據點



龍科新廠

研發中心、半導體特化材料

預計2028年完工

桃園廠

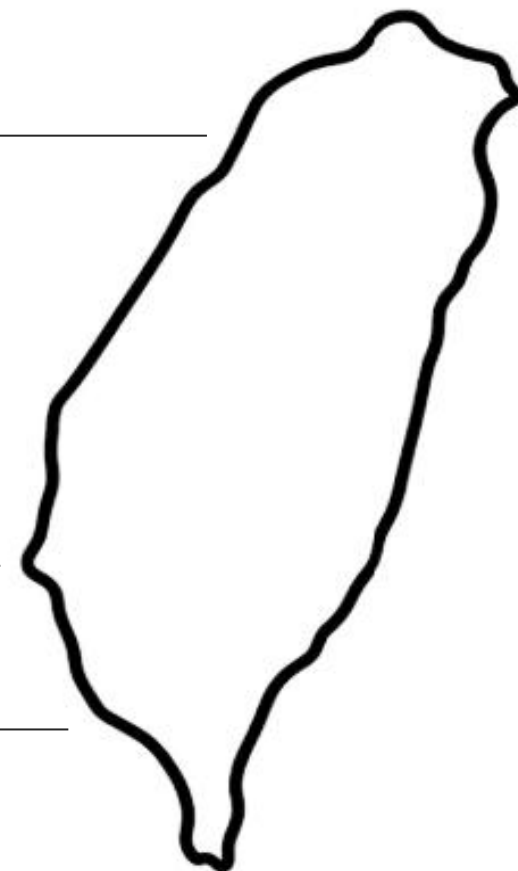
顯示器特化材料
光學元件材料

台南廠

半導體特化材料

高雄廠

半導體特化材料



主要客戶先進製程產能布局(2025~)

台灣

新竹寶山
4 Phases

台中
4 Phases

台南
9 Phases

高雄
6 Phases



美國

亞利桑那
4/3/2nm
8+ Phases

日本

熊本
28/22/16/12/3nm
2 Phases

德國

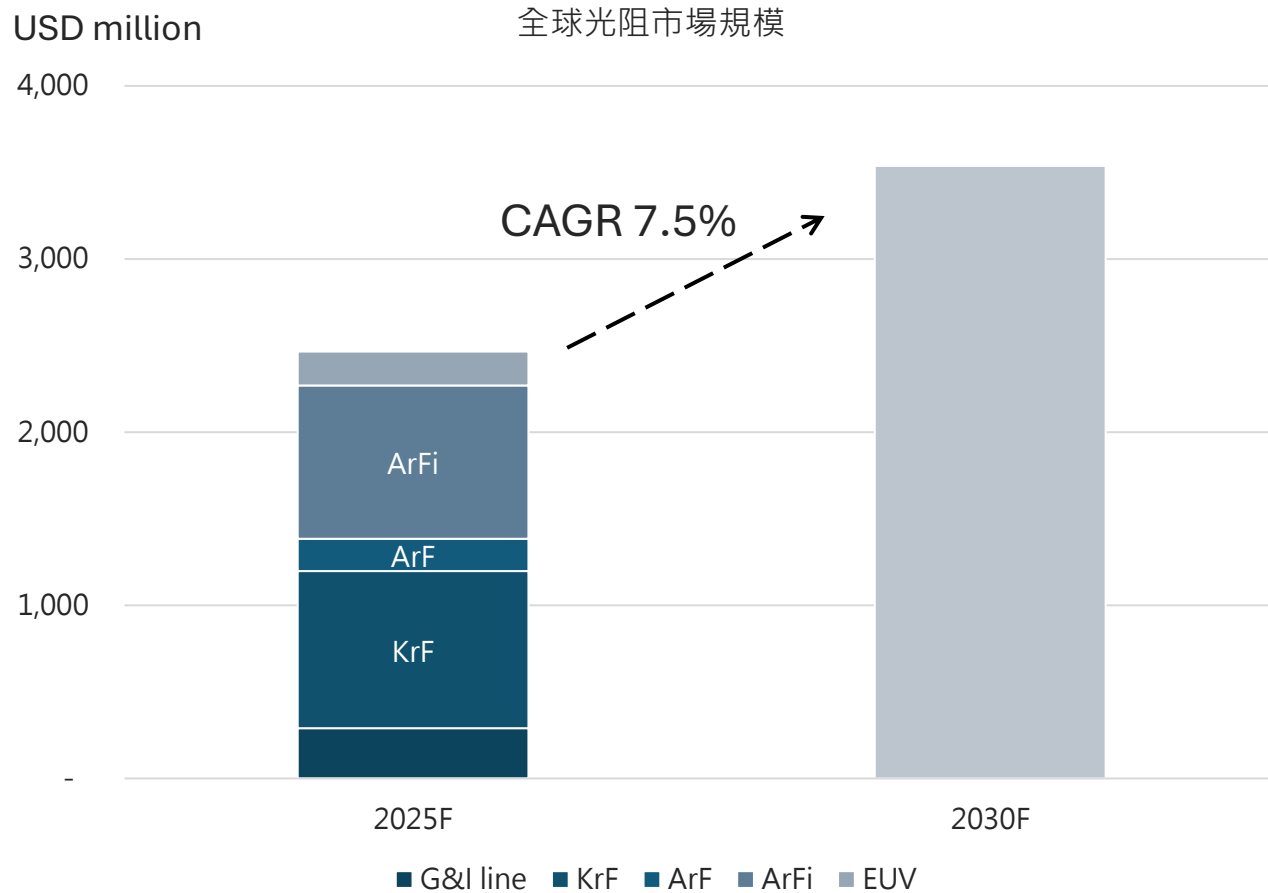
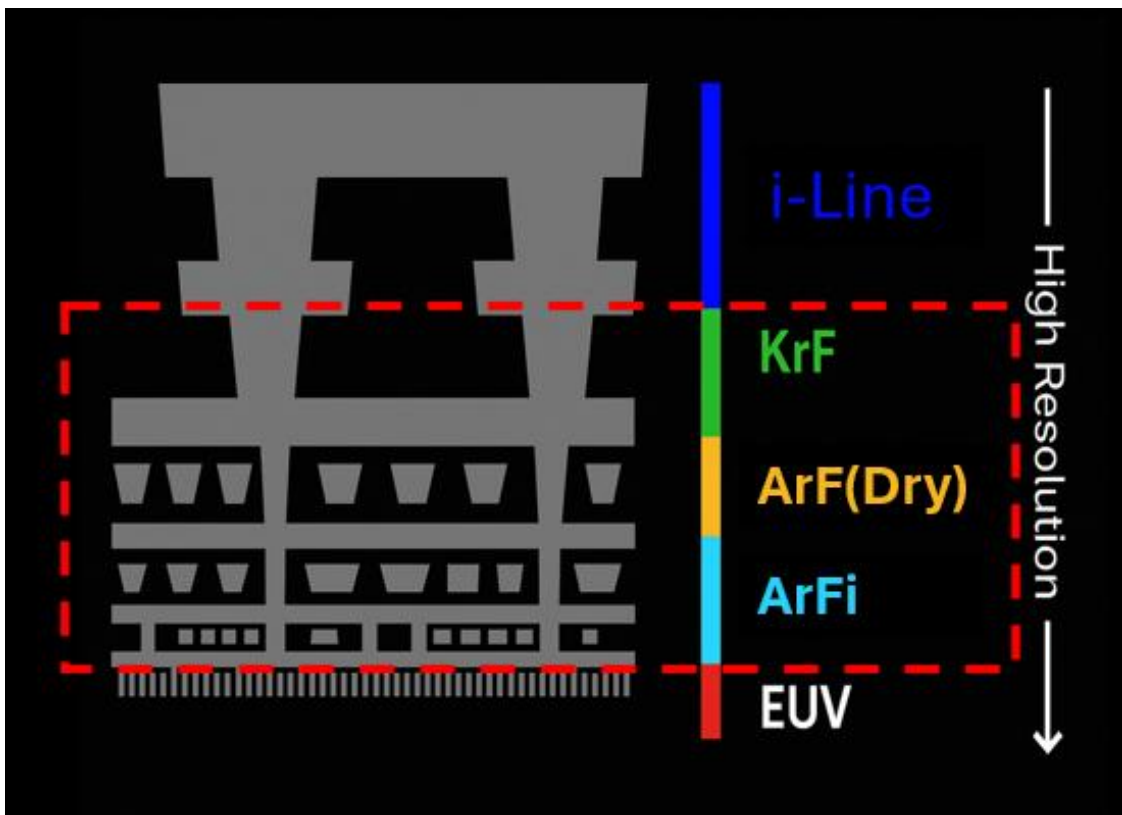
德勒斯登
28~12nm車用晶片
1 Fab

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

Application Field	Mass Production	Verification	Developing
Advanced Microlithography Materials	<ul style="list-style-type: none"> Rinse Material (表面改質劑) BARC (底部抗反射層) EBR (洗邊劑) Cleaner (清洗劑) 	<ul style="list-style-type: none"> Rinse Material for next node BARC for next node EBR for next node Cleaner for next node DUV Photoresist (KrF) 	<ul style="list-style-type: none"> Bottom Layer for next node Advanced BARC Protection Layer DUV Photoresist (ArF)
Advanced Packaging Materials	<ul style="list-style-type: none"> Temporary Protection Layer Plasma Dicing Glue 	<ul style="list-style-type: none"> Protection Layer for SoIC KrF BARC Cleaner Protection Glue for CPO Leveling Layer 	<ul style="list-style-type: none"> High AR Photoresist Packaging Glue Photoresist for Fine pitch QFN
Optical Element Materials	<ul style="list-style-type: none"> Photoresists (光阻劑) Flat Layer (平坦層) Color Filter Layer (濾光層) Light-cut Layer (遮光層) Lift-off Layer(離型層) 	<ul style="list-style-type: none"> DUV Photoresist (ArF) Stripper Lift-off Layer for next node ArF BARC Adhesion Layer 	<ul style="list-style-type: none"> Leveling Layer Microlens Materials

全球光阻市場規模



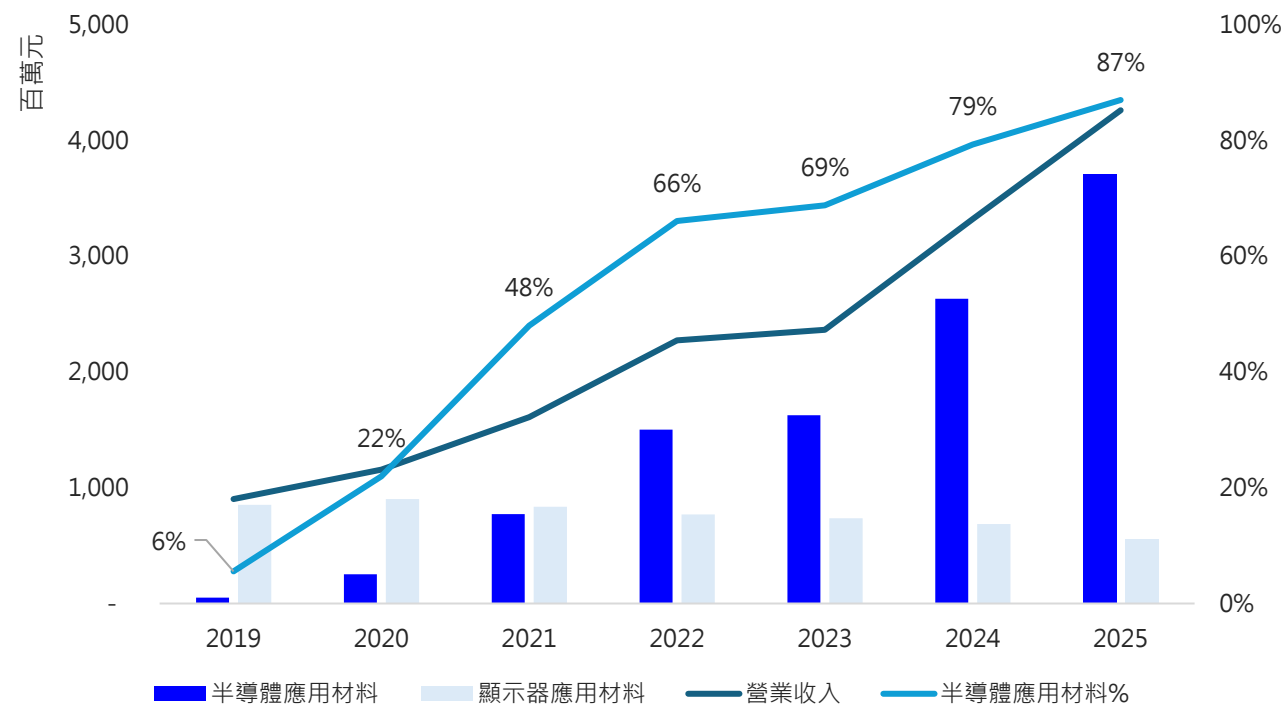
Source: TECHCET(2021) 、WSTS(2024) 、Deloitte(2025) 、 Estimate by Company

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

營收及獲利情形

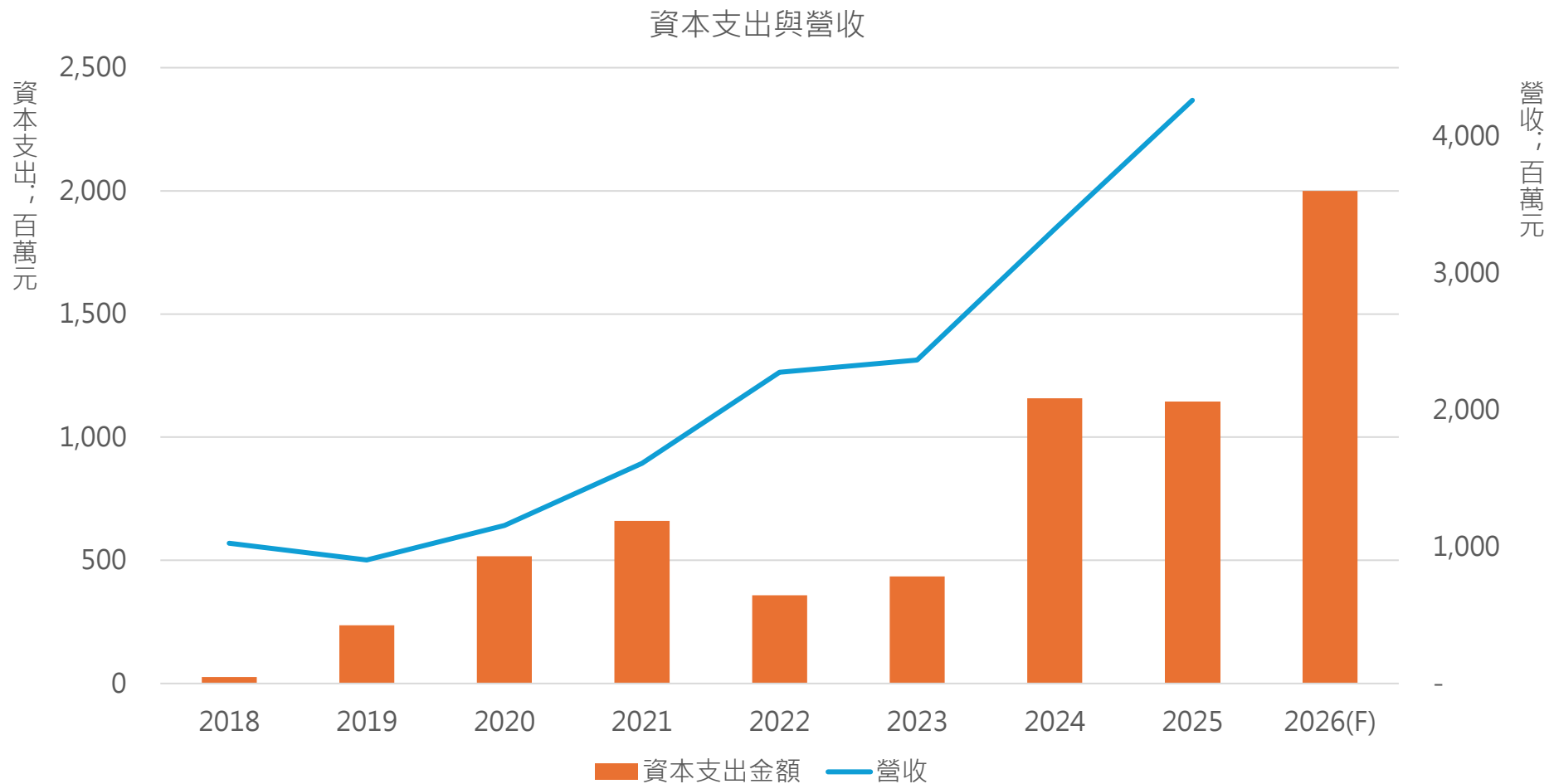
簡明損益表



年度	2021	2022	2023	2024	2025	1Q2026
營業收入	1,609	2,274	2,364	3,322	4,262	1,246
半導體應用材料	773	1,503	1,627	2,634	3,708	1,108
顯示器應用材料	836	771	737	688	554	138
營業毛利	422	723	694	1,204	1,835	566
毛利率	26.2%	31.8%	29.4%	36.3%	43.1%	45.4%
營業(損)益	53	295	225	587	1,061	337
歸屬母公司淨利	122	404	318	698	1,044	340
每股盈餘	1.62	5.01	3.91	8.50	11.33	3.66

資本支出

自2018年轉型半導體材料開發，累計至2025年資本支出投入已超過40億元



ESG永續實績

社會參與



結合企業倡議與員工投入響應，持續深化公益及環境永續行動

節能減碳



較法規時程提前完成溫室氣體盤查，2024、2025年取得第三方查證機構核發聲明書

榮獲重要晶圓代工客戶頒發「供應商節能減碳輔導專案」感謝狀

人才永續



成立「新應材獎學金」培育材料專才、成立「新住民子女獎助學金」栽培多元人才、積極參與「產學合作」，為半導體產業發展恪盡責任。

公司治理



4席獨立董事，占比>44%
2席女性董事，占比>22%

2025年初次發行永續報告書，每年定期發行

友善職場



公司重視性別平權與多元發展，女性員工及女性主管占比皆超過30%。

The background of the slide is a high-tech, futuristic image of a circuit board. It features glowing blue and orange lines representing data paths and binary code (0s and 1s) scattered throughout. A central, multi-layered square structure is highlighted with a bright blue glow.

意見交流

謝謝聆聽

For further information, please visit our website at:
<https://www.aemc.com.tw/>

Contact Investor Relations at:
ir@aemc.com.tw

損益表

單位:新台幣百萬元	1Q26	4Q25	1Q25	QOQ	YOY
營業收入淨額	1,246	1,085	959	14.8%	29.8%
營業毛利	566	477	375	18.6%	51.0%
營業毛利率	45.4%	44.0%	39.1%	3.3%	16.3%
營業費用	229	224	183	1.8%	24.7%
營業淨利	337	253	191	33.2%	76.1%
營業淨利率	27.1%	23.3%	19.9%	16.0%	35.7%
營業外收入及支出	73	72	59	1.5%	23.9%
歸屬予母公司業主之本期淨利	340	262	208	29.8%	63.4%
每股盈餘(新台幣元)	3.66	2.85	2.28	28.4%	60.5%

資產負債表

單位:新台幣百萬元	1Q26		4Q25		1Q25	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	865	8.0%	938	8.6%	2,769	27.4%
應收帳款	615	5.7%	536	4.9%	528	5.2%
不動產、廠房及設備	3,881	35.7%	3,743	34.4%	2,942	29.1%
資產總計	10,881	100.0%	10,469	96.2%	10,113	100.0%
流動負債	1,679	15.4%	967	8.9%	1,391	13.8%
長期借款	-	0.0%	-	0.0%	225	2.2%
負債總計	1,931	17.7%	1,217	11.2%	1,758	17.4%
股東權益總計	8,942	82.2%	9,252	85.0%	8,355	82.6%
重要財務指標						
流動比率	332%		638%		463%	
負債比率	18%		12%		17%	
每股淨值(新台幣元)	96.42		99.77		90.09	

現金流量表

單位:新台幣百萬元	1Q26	4Q25	3Q25
期初現金	965	1,778	2,569
營運活動之現金流入	219	215	158
折舊及攤銷費用	77	76	224
資本支出	(192)	(698)	(124)
長期借款	0	0	(974)
期末現金	893	965	1,778
自由現金流量	27	(483)	34

目錄

- 公司簡介
- 主要產品與市場規模
- 產品開發計畫
- 財務數據
- ESG永續實績
- 補充資料

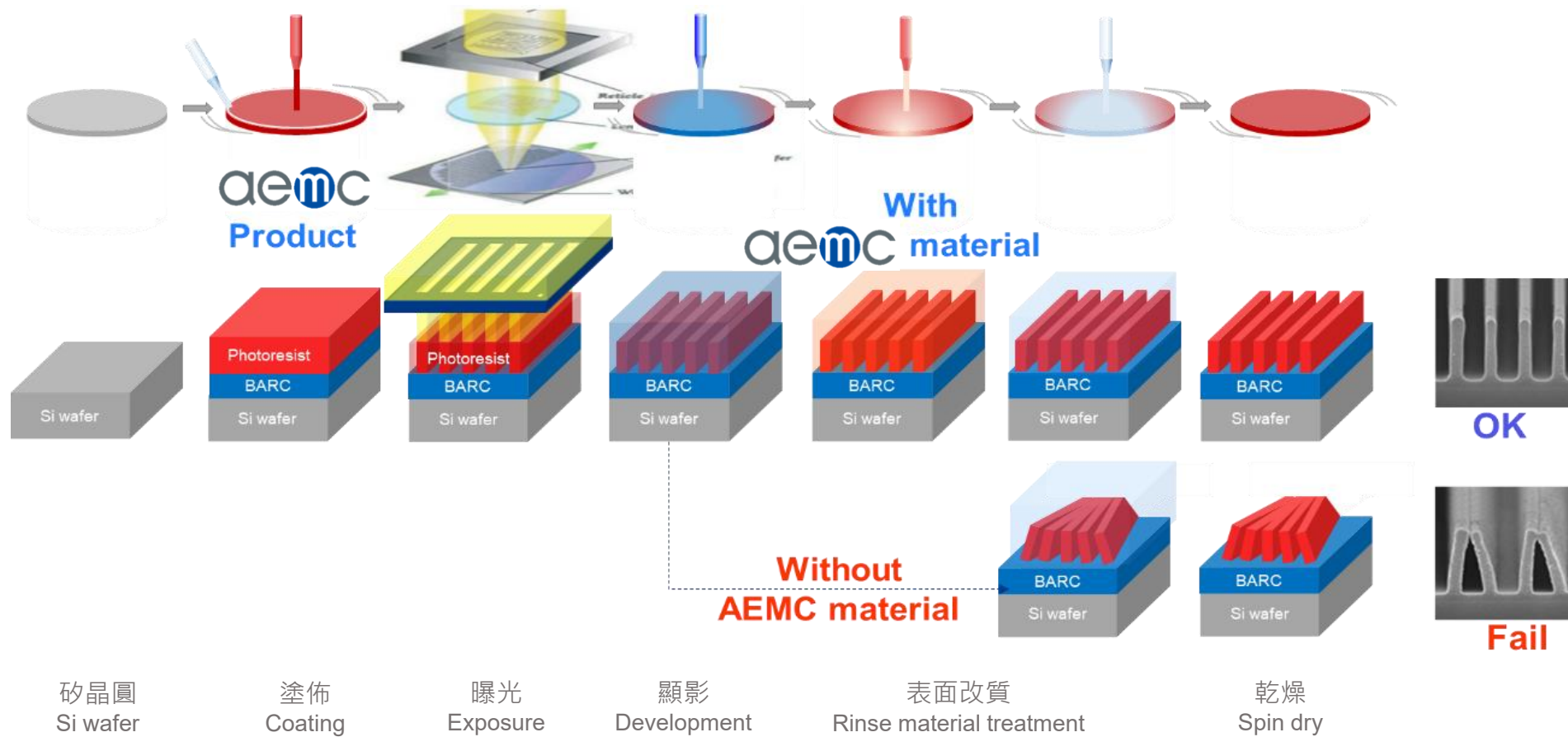
半導體先進微影製程材料

aemc
產品

- 抗反射劑BARC
- 洗邊劑EBR

- 表面改質劑
Rinse Material

- 清洗劑Cleaner
(管路、設備)



矽晶圓
Si wafer

塗佈
Coating

曝光
Exposure

顯影
Development

表面改質
Rinse material treatment

乾燥
Spin dry

半導體先進製程良率之關鍵材料：Rinse表面改質劑

效益 Benefits

- √ 製程簡單 Straightforward process
- √ 降低圖案缺陷 Pattern collapse mitigation
- √ 降低缺陷 Defect reduction

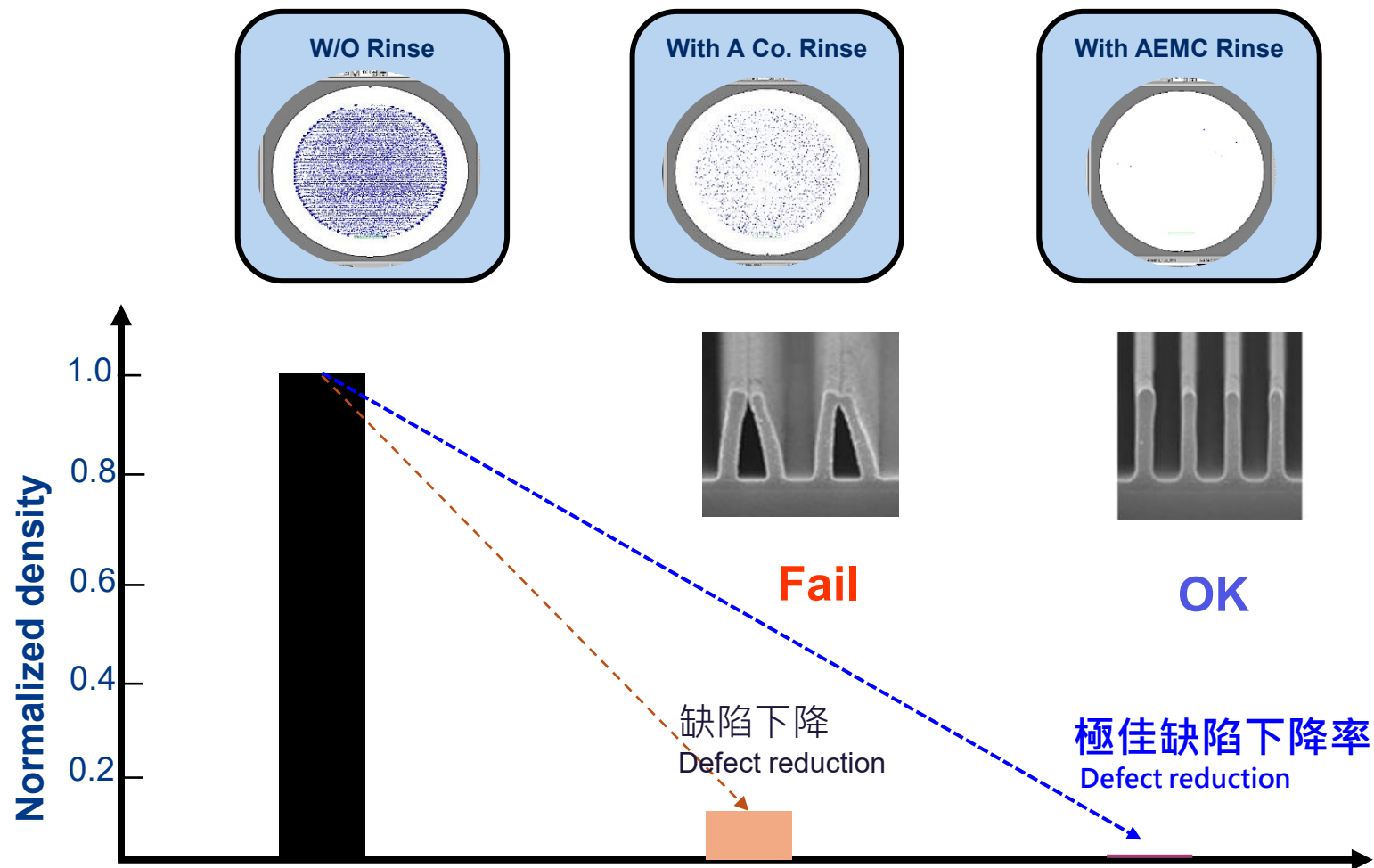
挹注專業資源，精進供應商研發力

微影製程在半導體製造過程至關重要，是確保晶片品質與穩定性的核心技術之一，因其材料研發及生產技術門檻高，過往主要仰賴進口供料。為提升本土供應鏈研發實力與生產效率，民國108年台積公司資材供應鏈管理處攜手奈米製像技術發展處展開「供應商原物料技術輔導計畫」，針對微影製程材料的「技術開發、品保分析、數據校正、樣品驗證、廠務配置、桶槽改善、擴產規畫」七大環節提供專業指導，不僅有效縮短供應商50%產線建置與產品驗證時間，其材料品質更優於台積公司製程標準、進一步提升良率，全方位強化供應商競爭力，為本土微影製程材料供應鏈發展奠定堅實基礎。



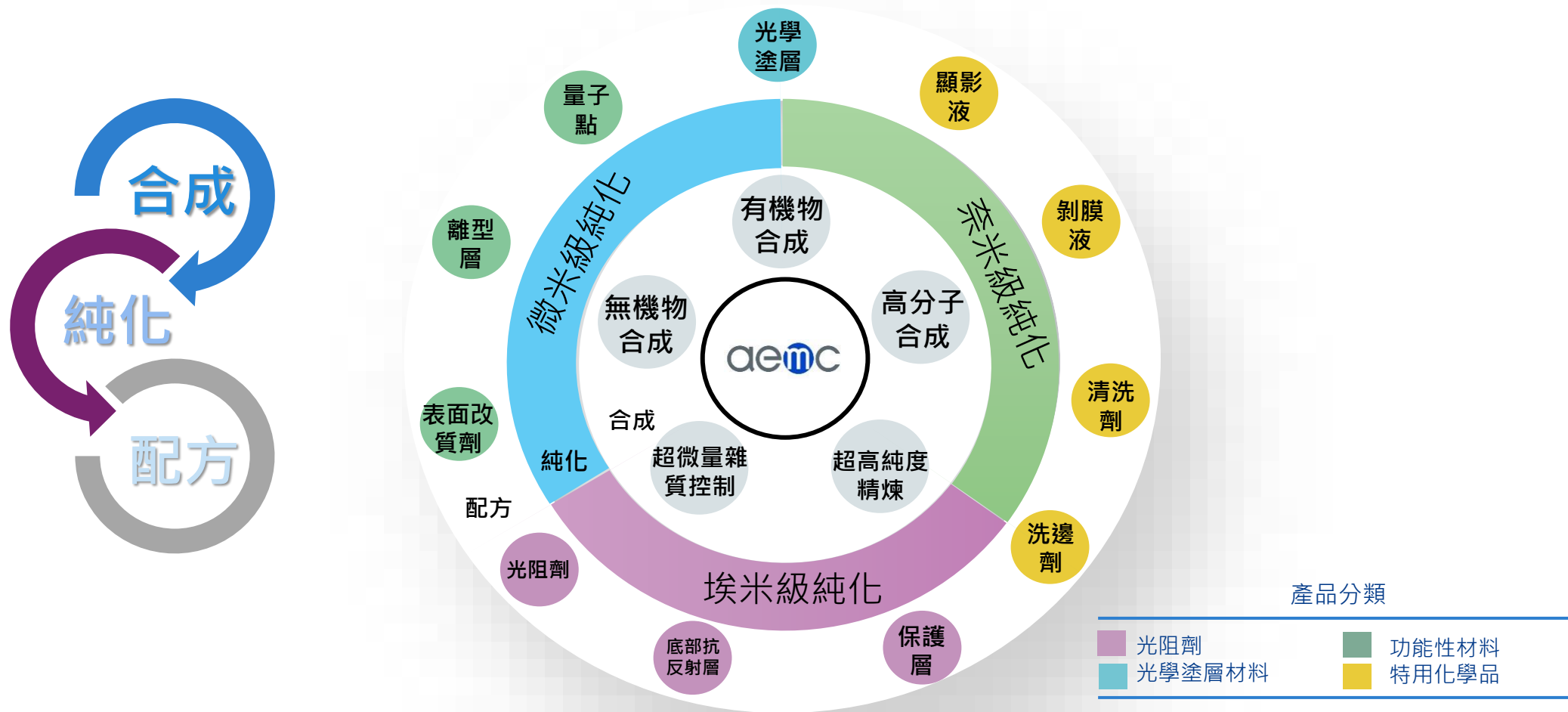
資料來源:晶圓代工客戶ESG永續管理網
<https://esg.tsmc.com/zh-Hant/articles/74>

Defect缺陷對比：新應材 Rinse材料性能世界No.1

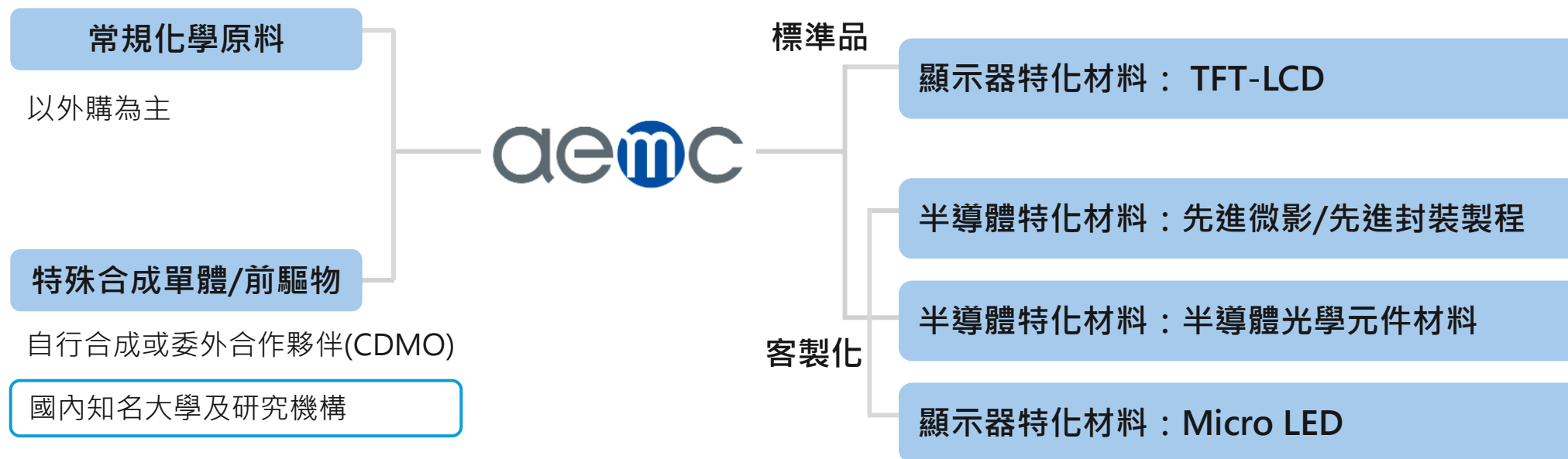


競爭優勢一、從配方開發向上整合自建原料合成能力

近20年材料/數千種材料配方資料庫



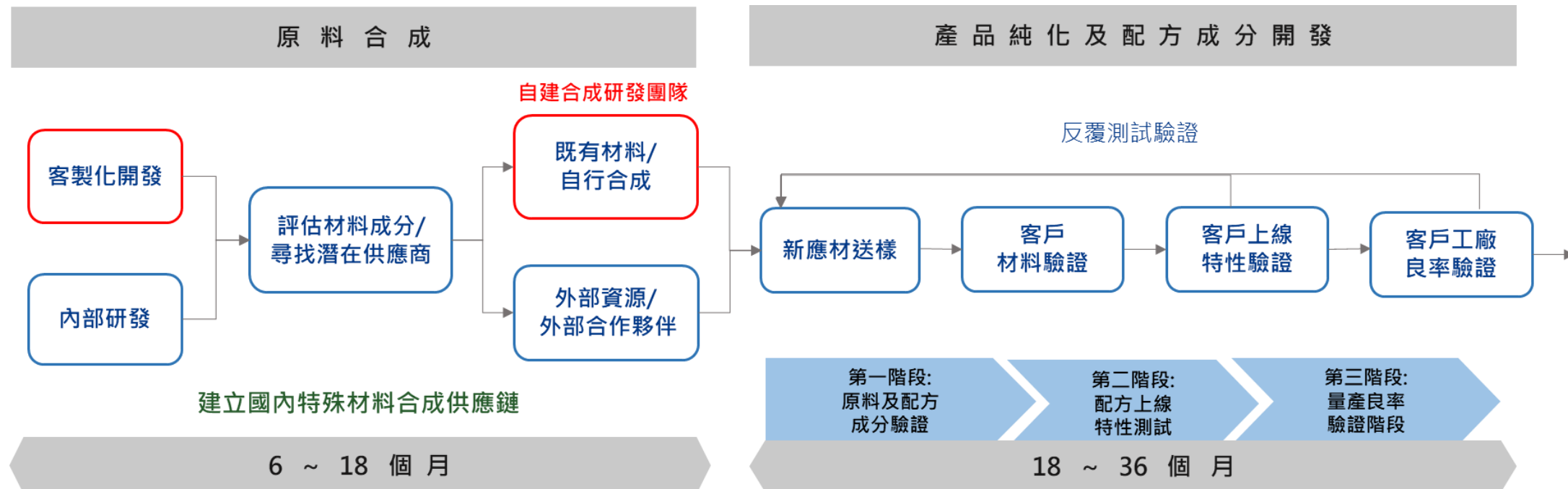
競爭優勢二、建立本土材料供應鏈的策略聯盟



競爭優勢三、快速回應及高學習曲線

客製化開發之回應速度及送樣頻率

遠高於國外大廠



競爭優勢四、優異的品質控管及自主設計的製程技術

優異的品質控管

✓ 品質控管設備與系統:

1. 建置與客戶同等級設備
2. 符合半導體最先進製程需求之超微量雜質控管: 由 ppb (10^{-9}) 進化到 ppt (10^{-12}) 等級
3. 智能品質監控系統: 自動化產品檢測與品質數據整合分析

自主設計的製程技術

產品階段

送樣



研發線
(R&D Lab)

試產



小批量生產線
(Mini line)

放量



大批量生產線
(HVM)

自建產線

國內外同業產品比較

量產品V 驗證中O

微影製程材料		aemc	B*	M*	J*	S*	F*	T*	S*	N*	D*
		台灣	德國	德國	日本	日本	日本	日本	日本	日本	美國
光阻	CIS	V					V				
	G/I-line	V		V	V	V	V	V	V		
	KrF	O		V	V	V	V	V	V		V
	ArF	O		V	V	V	V	V	V		V
	EUV				V	V		V	V		
週邊材料	抗反射劑 (BARC)	V								V	V
	表面改質劑 (Rinse)	V		V							
	清洗劑 (Cleaner)	V	V								
	顯影劑 (Developer)	V						V			
	洗邊劑 (EBR)	V	V	V	V			V			
	絕緣層材料	O								V	

註:兆豐證券整理，彙整自公司官網及公開資訊等。上述材料聚焦於半導體前段製程。